

GXP6295 压力传感器

1 基本性能

- 宽压力范围
- 自主知识产权芯片设计
- 高精度、已校准补偿
- 温度补偿范围：-5~65°C
- 采用表面贴 SMT 封装
- 电源范围：4.75V~5.25V
- 封装方式：SOP16

2 应用范围

- 医疗监测：呼吸机等呼吸系统、医疗病床
- 工业控制：消防余压监测、暖风空调
- 白色家电：洗衣机液位和压力测量

3 芯片概述

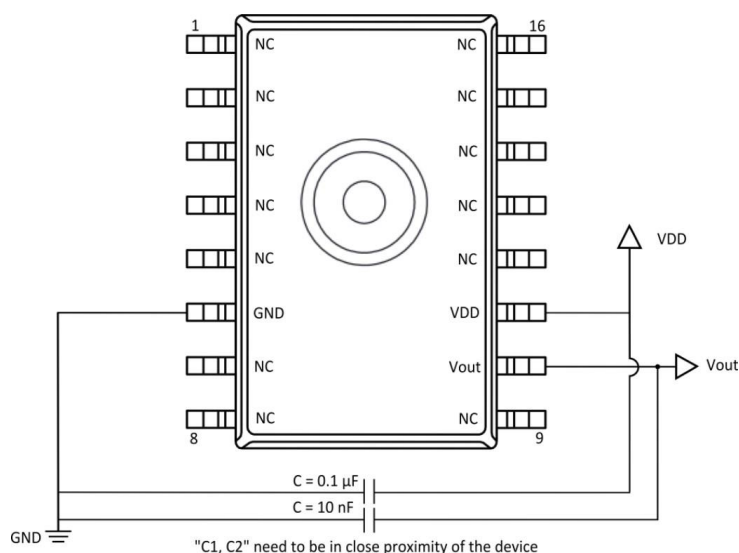
GXP6295 系列压力传感器是一种超小型的集成式低压高精度半导体压力传感器，适用于医疗、工业控制、白色家电等领域。采用标准的表面贴 SMT 封装形式，方便用户后续进行安装使用。

利用 MEMS（微机械电子系统简称）技术加工的硅压阻式压力敏感芯片，该传感器采用算法实现多阶温度补偿，提供与所施加的压力成比例的精确、模拟电平输出信号。

芯片封装信息

产品编号	封装信息	芯片封装面积(NOM)
GXP6295	SOP16	10.26mm*7.52mm

典型应用



12 订购信息

购买编码	器件	封装	LOGO	包装数量	包装形式
GXP6295-BGE-S-040-000	GXP6295	SOP16	GXP6295-E-040	47	料管

13 版本更新信息

版本	日期	描述	修改页
V1.0	2023.11.05	初始版	所有

NOTE

以上内容为中科银河芯推荐的 GXP6295 的注意事项。客户在参照以上内容使用 GXP6295 时，应根据自身的使用需求和应用场景，提前评估采用的相关组件是否合乎目标用途，测试并验证所搭建的测压系统功能的正确性，以避免造成损失。